

DDR2 SO DIMM 插槽

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 2

堆叠高度: 5.2 mm

模块方向: 直角

位数: 200

中心线 (间距) : .6 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D3301-SO1339
---------	------------------

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR), 双倍数据速率 (DDR) 2

结构特性

行数	2
托架数	2
钥匙数	1
模块方向	直角
位数	200

电气特征

DRAM 电压 (V)	1.8, 2.5
-------------	----------

信号特征

SGRAM 电压 (V)	1.8, 2.5
--------------	----------

主体特性

固定柱材料	铜合金
模块钥匙类型	SGRAM, 左偏移
弹射器位置	两端
弹射器类型	锁定



插销材料	不锈钢
固定柱位置	中心
插销电镀材料	锡
连接器外形	低, 标准, 超高

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	金, 镀金
端子基材	铜合金
内存插槽类型	内存卡
端子额定电流（最大值） (A)	.5
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	.76
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	30

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	反向键控, 标准键控
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾, 焊钉

壳体特性

壳体颜色	灰色, 黑色
外壳材料	LCP, 高温热塑塑料
中心线（间距） (mm)	.6
中心线（间距） (in)	.024

尺寸

堆叠高度 (mm)	4, 4.6, 5.2, 6.5, 8, 9.2
堆叠高度 (in)	.157, .18, .205, .256, .315, .362
行间距 (mm)	5.6, 5.8, 6.2
行间距 (in)	.22, .228, .244

使用环境

--	--



工组温度范围 (°C)	-55 - 85
-------------	----------

工组温度范围 (°F)	-67 - 185
-------------	-----------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	16, 20, 150, 200
------	------------------

封装方法	Box, Reel, Tray, 半硬托盘组件, 卷带包装, 硬托盘
------	------------------------------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4	SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM SOCKET 200P 6	HARD TRAY ASS'Y DDR SODIMM SOC
TE 产品编号	1717379-4	1565691-4	1717468-3	1612507-3
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR)	双倍数据速率 (DDR)	双倍数据速率 (DDR)
堆叠高度	5.2 mm	4 mm	6.5 mm	5.2 mm
连接器外形	标准	低	标准	标准
行间距	6.2 mm	5.6 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接触部电镀材料	镀金	镀金	镀金	镀金
端子接合区域电镀材料厚度				
封装方法	卷带包装	半硬托盘组件	Tray, 半硬托盘组件	硬托盘
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR SODIMM,DDR2 SO DIMM	DDR SODIMM,DDR2 SO DIMM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



EMBOSS DDR2 SODIMM
200P 4H STD



SEMI-HARD TRAY DDR2
SODIMM 6.5H STD(HSG)



DDR SODIMM SOCKET
200POS SEMI-



SEMI HARD TRAY DDR
SOCKET 200P

TE 产品编号	292406-4	5-1746530-4	1612618-1	1-1473005-1
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR)	双倍数据速率 (DDR)
堆叠高度	4 mm	6.5 mm	9.2 mm	5.2 mm
连接器外形	标准	标准	超高	标准
行间距	5.8 mm	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接触部电镀材料	镀金	镀金	镀金	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm			
封装方法	Reel	Box, Tray	半硬托盘组件	半硬托盘组件
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR SODIMM,DDR2 SO DIMM	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 4	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5	SEMI-HARD TRAY ASSY DDR 200P 5	SEMI-HARD TRAY ASSY DDR2 SODIMM 5.2H RV
TE 产品编号	1827236-4	1473006-4	1473149-1	1473150-4
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR)	双倍数据速率 (DDR) 2
堆叠高度	4.6 mm	5.2 mm	5.2 mm	5.2 mm
连接器外形	低	标准	标准	标准
行间距	5.6 mm	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接触部电镀材料	镀金	镀金	镀金	镀金
端子接合区域电镀材料厚度				
封装方法	Box, Tray	半硬托盘组件	Tray, 半硬托盘组件	Box, Tray
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 9	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 6	SEMI-HARD TRAY ASS'Y FOR DDR S
TE 产品编号	1473005-1	1612618-4	1612773-4	1565691-1
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR)	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR)
堆叠高度	5.2 mm	9.2 mm	6.5 mm	4 mm
连接器外形	标准	超高	标准	低
行间距	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm	5.6 mm
端子接触部电镀材料	镀金	镀金	镀金	镀金
端子接合区域电镀材料厚度				
封装方法	半硬托盘组件	半硬托盘组件	半硬托盘组件	半硬托盘组件
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR SODIMM	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H	EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H	SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 9.2H STD AMC	EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H
TE 产品编号	1565917-4	1565918-4	1981284-4	1717254-4
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2	双倍数据速率 (DDR) 2
堆叠高度	5.2 mm	5.2 mm	9.2 mm	5.2 mm
连接器外形	标准	标准	标准	标准
行间距	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm	6.2 mm
端子接触部电镀材料	镀金	镀金	金 (Au)	镀金
端子接合区域电镀材料厚度				
封装方法	卷带包装	卷带包装	Box, Tray	卷带包装
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM	DDR2 SO DIMM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

